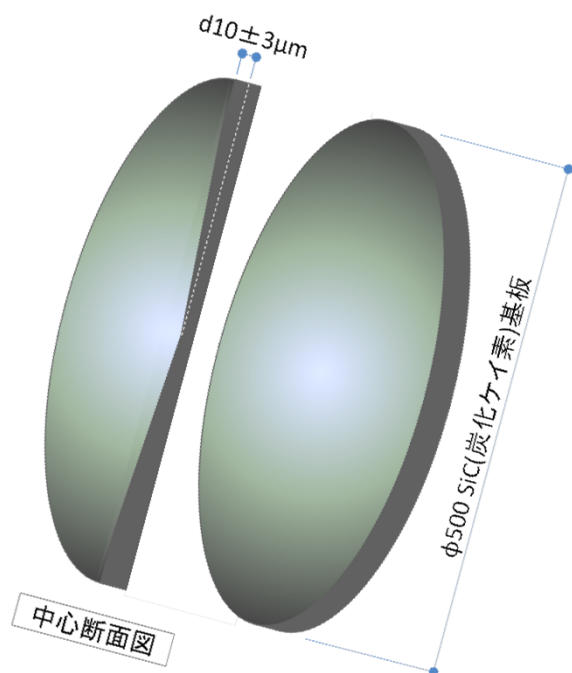


φ500大口径セラミックス 凹面研削 公差3μm

φ450ウェハ用静電チャック対応

半導体製造装置の大口径化(φ450)に対応した、ロータリ研削盤と、最大φ500mmの平面度及び平行度が測定できる測定器を開発、導入しました。ロータリ研削盤は、凹面形状の作り込みが定量的に行える機能を有し、測定器で取得した形状データに基づくフィードバック加工を容易に行うことができます。初期の試作開発向けに、形状の作り込みが容易で、少量多品種に幅広く対応したシステムとなっており、
※本システムは「平成24年度 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」により構築したものです。



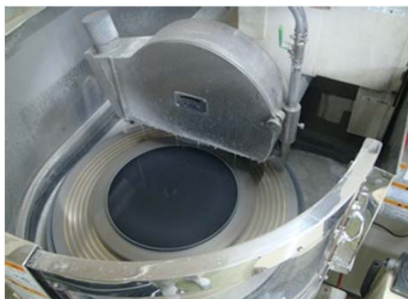
◆ 凹面研削仕上げの表面状態(実績値)

SiC	Ra≤0.03
Al2O3	Ra≤0.05
Si	Ra≤0.05
LTCC	Ra≤0.08

◆ 設備 (加工機と測定装置)

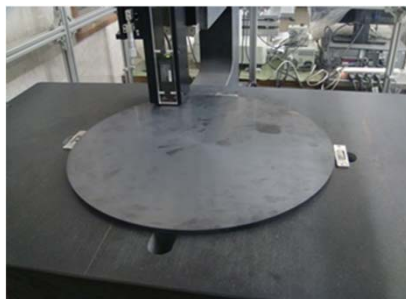
(Ⅰ) ロータリ研削盤

凹面形状の定量的な作り込みが可能



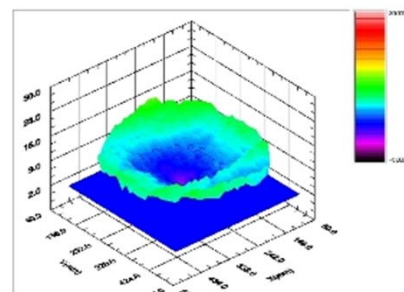
(Ⅱ) 平面度・平行度測定装置

最大φ500mmの測定が可能



(Ⅲ) 測定データ

凹面の作り込みに必要な形状データ



セラミックス・ガラス・結晶材料の精密微細加工

切断

研削

研磨

マシンニング